



Not Rated

주가(7/19): 1,895원

시가총액: 1,625억원

반도체

Analyst 박유악

02) 3787-5063 / yuak.pak@kiwoom.com

RA 권준수

02) 3787-3760 / wkud1222@kiwoom.com

Stock Data

KOSDAQ(7/19)	1,049.83pt	
52 주 추가동향	최고가 2,075 원	최저가 610원
최고/최저가 대비 등락율	-8.7%	210.7%
수익률	절대	상대
1M	-6.0%	-9.0%
6M	116.8%	97.8%
1Y	157.8%	92.3%

Company Data

발행주식수	85,728 천주
일평균 거래량(3M)	3,735천주
외국인 지분율	2.8%
배당수익률(20)	0.0%
BPS(20)	1,241원
주요 주주	테라닉스 35.8%

투자지표

(십억원, IFRS 연결)	2017	2018	2019	2020
매출액	265.6	250.2	218.8	201.5
영업이익	2.8	-7.2	-19.6	-14.5
EBITDA	31.5	19.2	4.8	4.9
세전이익	3.0	-7.7	-27.4	-42.1
순이익	1.6	-6.2	-22.9	-37.3
지배주주지분순이익	1.6	-6.2	-22.9	-37.3
EPS(원)	19	-73	-268	-436
증감률(%YoY)	흑전	적전	적지	적지
PER(배)	69.8	-11.9	-4.3	-2.0
PBR(배)	0.67	0.50	0.72	0.69
EV/EBITDA(배)	4.2	4.6	21.6	9.3
영업이익률(%)	1.1	-2.9	-9.0	-7.2
ROE(%)	1.0	-4.0	-16.2	-30.7
순부채비율(%)	12.0	9.1	4.0	-25.8

자료: 키움증권 리서치센터

Price Trend



기업 업데이트

시그네틱스 (033170)

실적 턴어라운드 후, 패키징 성장 가시화



반도체 제조 과정 중 후공정에 속하는 패키징 사업을 영위하는 업체로서 삼성전자, SK하이닉스, Broadcom, Cypress 등을 주요 고객으로 하고 있음. 4Q20 영업이익 흑자전환 후 1Q21 2분기 연속 흑자에 성공하며 실적 턴어라운드 가시화. 금년 주요 유동자산 감가상각 완료에 따른 손익개선 효과, 메모리 패키징 수요 증가로 매출의 증가가 예상되기 때문.

>>> 반도체 패키징 전문 업체

시그네틱스는 반도체 제조 과정 중 후공정에 속하는 패키징 사업을 영위하는 업체로서, 삼성전자, SK하이닉스, Broadcom, Cypress 등을 주요 고객으로 하고 있다. 매출 비중은 2020년 기준으로 메모리와 비메모리가 각각 38%와 62%이며, 삼성전자와 Broadcom이 각각 32%와 25%로 높은 비중을 차지하고 있다. 플립칩(Flip Chip), Thermal Enhanced BGA(Ball Grid Array), FBGA(Fine Pitch BGA), MCM(Multi Chip Modules) 등의 첨단 패키지 기술을 보유하고 있으며, 2017년부터 플립칩 라인을 지속적으로 증설 및 가동하여 매출 증대를 도모하고 있다.

>>> 4Q20 이후 실적 턴어라운드 가시화

시그네틱스는 지난 3년 연속 영업이익 및 당기순이익 모두 적자를 기록했으나, 4Q20에 영업이익 흑자전환에 성공했다. 흑자전환은 무엇보다, 대규모 유형자산 '손상차손'을 인식하는 회계처리의 결과로 감소한 감가상각비와, 하반기 매출액 증가에 기인한다. 또한, 1Q21의 전년비 평균 가동률의 개선(45% > 54%) 효과도 흑자전환 달성에 기여했다.

한편 시그네틱스는 기존의 해외 고객사에 집중해오던 판매 전략에서 국내 고객사 비중을 확대하며 안정적인 매출처 확보를 위해 노력하고 있다. 그 결과 지난 4분기 38%이던 메모리 부문 매출 비중이 올해 1분기 53%로 늘어났고 매출액도 증가했다.

>>> 첨단 패키지 기술개발을 통한 경쟁력 강화

국내 메모리 고객사의 모바일 NAND 플래시 패키징 수요 증가로 동사 메모리 부문 매출 수준은 유지될 것이다. 또한 해외 비메모리 업체로의 통신용 패키징 수요가 늘어나고 있으며, 하반기부터 매출이 큰 폭으로 성장할 것으로 판단한다. 한편 시그네틱스는 LAB(Laser Assisted Bond System) 기술, Fingerprint Sensor 패키지 기술, Recon Flip Chip 기술 등 신규 사업에 대한 기술 개발 및 투자도 지속하고 있다. 지문인식센서 패키징의 경우 향후 중화권 고객사 확대 및 전방 시장 상황이 개선될 경우 매출에 기여할 것으로 예상된다.

Compliance Notice

- 당사는 7월 19일 현재 '시그네틱스' 발행주식을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 동 자료를 기관투자자 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료의 금융투자분석사는 자료 작성일 현재 동 자료상에 언급된 기업들의 금융투자상품 및 권리를 보유하고 있지 않습니다.
- 동 자료에 게시된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.

고지사항

- 본 조사분석자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없고, 통지 없이 의견이 변경될 수 있습니다.
- 본 조사분석자료는 유가증권 투자를 위한 정보제공을 목적으로 당사 고객에게 배포되는 참고자료로서, 유가증권의 종류, 종목, 매매의 구분과 방법 등에 관한 의사결정은 전적으로 투자자 자신의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행해진 일체의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않으며 법적 분쟁에서 증거로 사용 될 수 없습니다.
- 본 조사 분석자료를 무단으로 인용, 복제, 전시, 배포, 전송, 편집, 번역, 출판하는 등의 방법으로 저작권을 침해하는 경우에는 관련법에 의하여 민·형사상 책임을 지게 됩니다.

투자의견 및 적용기준

기업	적용기준(6개월)	업종	적용기준(6개월)
Buy(매수)	시장대비 +20% 이상 추가 상승 예상	Overweight (비중확대)	시장대비 +10% 이상 초과수익 예상
Outperform(시장수익률 상회)	시장대비 +10~+20% 추가 상승 예상	Neutral (중립)	시장대비 +10~-10% 변동 예상
Marketperform(시장수익률)	시장대비 +10~-10% 추가 변동 예상	Underweight (비중축소)	시장대비 -10% 이상 초과하락 예상
Underperform(시장수익률 하회)	시장대비 -10~-20% 추가 하락 예상		
Sell(매도)	시장대비 -20% 이하 추가 하락 예상		

투자등급 비율 통계 (2020/07/01~2021/06/30)

매수	중립	매도
98.10%	1.90%	0.00%